

GC7615B 应用指导

概述

GC7615B 是在 GC7615A 的基础上换工艺厂重新设计投片的，与 GC7615A 管脚与功能完全兼容，只是芯片面积由以前的 1.8mm*1.77mm 改成了 1.5*1.48mm。芯片面积缩小后，芯片在 PCB 板上占的面积也会减小，客户布线的空间就会增加，对于需要将 PCB 背面两边刨去，导致背面不能走线的游标卡尺来说有了布局的空间。还有将开机自检（全显）时间缩短了，GC7615A 开机全显时间是 1S(300K)，GC7615B 开机全显时间是 0.3S（280K）。

应用建议

GC7615B 封装形式采用 QFN48 脚 6mm*6mm 和裸芯片两种方式，如果客户 PCB 板子上有空间的话，建议客户将 PCB 改成 QFN 封装和裸芯片邦定都可以用的方式，这样客户就不至于因为封装的问题而影响生产的进度。注意画 QFN 封装的时候，中间加上底托（中间放一个焊盘，用于没有 QFN 封装货源的时候，采用邦定的方式放置裸芯片），还有加工的时候**注意要求沉金**。

使用 QFN 封装，由于封装底部中间有很大的焊盘（封装内部接地），如果按照封装图上的尺寸画，中间就不能走线，如果因此造成很大的不便，可以将中间的焊盘缩小或者不画，但是必须格外注意，**内部走线或者放置过孔的话，PCB 加工的时候，中间的走线和过孔务必要加上阻焊层**。

使用裸片，则相对比较灵活，遇到走不通的线也可以在周围的管脚的加上一些走线或者有利于走线的管脚，邦定的时候注意按照芯片本身的管脚顺序邦定，只是用来走线方便的管脚不邦定即可。

文档修改记录

版本	更改内容（每行一项）	更改日期&更改者（简写）
V10	发布	2024-7-23 by wyq
V11		2024-9-3 by wyq